



平成 24 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 ワイエイシー株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 百瀬 武文  
(コード番号 6298 東証第一部)  
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 宮 本 忠 泰  
(TEL. 042-546-1161)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり定款の一部変更を平成 24 年 6 月 28 日開催予定の第 40 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

##### 1. 定款変更の目的

現行定款第 2 条に定める目的について、今後の事業領域の拡大に備えて、目的を追加変更を行うものであります。

##### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
第 2 条 (目的) 当社は次ぎの各号の事業を営むことを目的とする。 1. 半導体製造関連装置、磁気ディスク製造関連装置、液晶ディスプレイ製造関連装置等の各種ハイテク装置の設計、製造、販売  2～7 (条文省略) (新設)  8. その他上記に関する事業	第 2 条 (目的) 当社は次ぎの各号の事業を営むことを目的とする。 1. 半導体製造関連装置、磁気ディスク製造関連装置、液晶ディスプレイ製造関連装置、 <u>その他電子部品製造関連装置</u> 等の各種ハイテク装置の設計、製造、販売 2～7 (現行どおり) 8. <u>電気炉およびヒーター</u> の設計、製造、販売 9. <u>放射線 (赤外線を含む) 応用加熱機器及びその関連機器</u> の設計、製造、販売 10. <u>医療用機器、空気清浄機、その他電気機器および器具</u> の設計、製造、販売 11. <u>レーザー応用機器</u> の設計、製造、販売 <u>12. その他上記に関する事業</u>

##### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 6 月 28 日

定款変更の効力発生日 平成 24 年 6 月 28 日

以 上